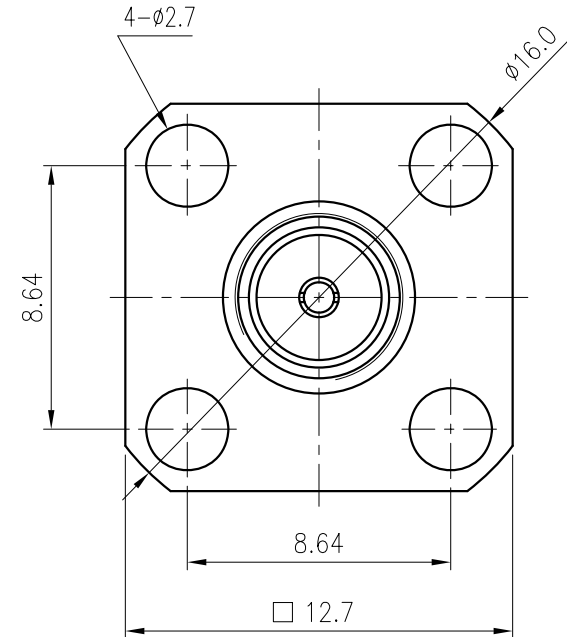
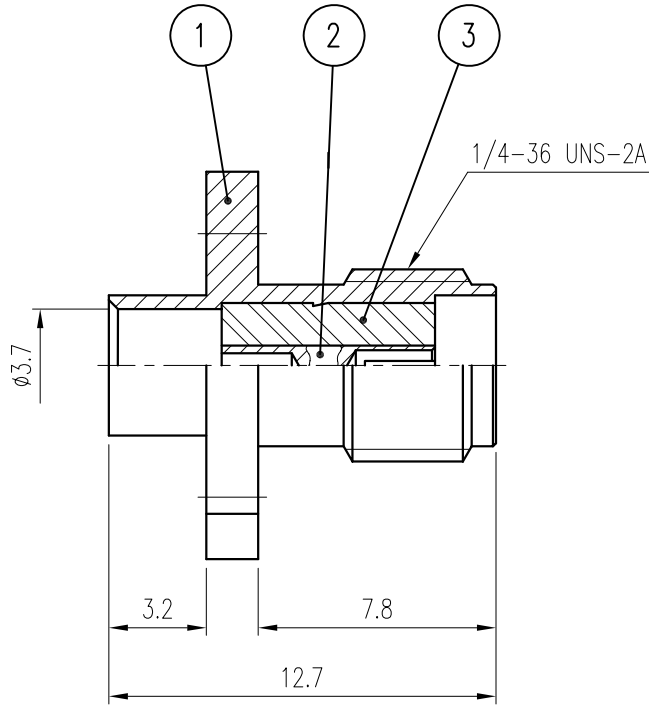


수 정 내 용														
부호	내 용										수정자	승인자	년 월 일	
1	케이블 삽입부 설변										손윤호	안병호	2004. 07. 12.	
2	커넥터 바디 내부 닦시베늘 추가										김인철		2017. 07. 18.	



△ 2	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00093-N/1 DIN00105-N/1 (H2016)	
	△ 2	2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00138-5/1 (E2017)
	△ 2	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00204-5/1 (D2029)
대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일			KJ COMTECH RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
* ±0.1		2017. 7. 18.					
.** ±0.05							
재질		검도			도명		
		재도					
열처리		작성부서			SMA50 CABLE JS-4H 141		
		연 구 소					
보호파막처리		척도 4/1	단위 mm	중량	A4	도번	
						CN00160-7/1 K314-371-000	